证券代码：300726　　证券简称：宏达电子

株洲宏达电子股份有限公司

（注册地址：湖南省株洲市荷塘区新华东路 1297 号）

2026 年度
向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年十一月

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“宏达电子”“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过 100,000.00 万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司就本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金 拟投入额
1	片式高分子聚合物钽电容产业化建设项目	58,136.45	53,000.00
2	陶瓷薄膜电路与SLC产业化建设项目	50,170.55	47,000.00
合计		**108,307.00**	**100,000.00**

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析

（一）片式高分子聚合物钽电容产业化建设项目

1、项目概况

钽电容器因具有优异的频率特性、长期稳定性和高单位体积电容值等特点，在高端电容器市场占据重要位置，在高可靠领域、AI、通信、工业设备等领域应用广泛。随着 AI 和通信领域的迅速发展，AI 服务器、存储等市场规模快速增长，拉动包括钽电容器在内的电子元器件的需求迅速增长。公司在对钽电容器、电子

元器件和下游应用领域发展趋势的深入研判的基础上，决定充分把握历史发展机遇，依托在高可靠领域深耕多年积累的核心技术能力、市场开拓能力、产品开发经验，投资建设片式高分子聚合物钽电容生产线，专注新一代片式高分子聚合物钽电容，面向 AI 服务器、存储等下游应用领域，进一步开拓高端民用市场、完善公司产品矩阵，进一步提升公司的竞争力和影响力。

2、项目的必要性和可行性

（1）必要性

1）抢占国内赛道先发优势，满足下游应用领域快速增长的市场需求

受 AI、通信等下游应用领域快速增长的拉动，钽电容器的需求迅速增长，特别是在 AI 服务器的领域，AI 服务器的高功耗架构已使得钽电容器的使用量发生了数量级的变化，AI 已成为钽电容市场规模增长的最重要驱动因素。目前，全球 AI 算力级聚合物钽电容产能主要集中在 KEMET、AVX、松下、Vishay 四家国际厂商，上述四家企业合计掌握全球约九成的该类产品产能，国产聚合物钽电容具有广阔的导入窗口。此次投资建设聚合物钽电容产能，有助于公司填补国产聚合物钽电容产能缺口，抢占赛道先发优势。

2）有助于公司补齐高端民用市场产能，进一步完善产品矩阵

公司深耕钽电容领域多年，原有钽电容业务以高可靠产品为主，并逐步拓展民用市场。本次投资建设聚合物钽电容产能，是公司进一步打开民用市场、补齐高端民用市场产能的重要举措，有助于公司完善产品矩阵，提升客户配套服务能力，构建高可靠产品和高端民用产品“双轮驱动”增长体系，实现从单一器件供应商向综合钽电容方案商的跨越式发展。

3）有助于公司进一步提升盈利能力，提高公司综合竞争能力

片式高分子聚合物钽电容技术壁垒相对较高，单颗价值高于普通钽电容器产品，属于钽电容器行业内的高价值赛道。本次投资建设聚合物钽电容生产线，有助于公司显著优化产品结构，进一步提升盈利能力，提高综合竞争能力。

（2）可行性

1）公司已建立完善的技术工艺和研发体系，能够保障本次项目顺利实施

公司深耕钽电容领域多年，掌握了钽阳极成型、烧结、导电高分子聚合、阴极制备、老化筛选等全套核心工艺，拥有多项专利，同时拥有 CNAS 认可可靠性实验室，可独立完成 SSST、温循、振动、浪涌、ESR/纹波等全套可靠性验证，能够有效把控产品质量，保证工艺稳定性。

公司建立了专门的钽电容人员研发体系，持续投入工艺迭代，可同步开发 AI 服务器、存储、工业、车规系列规格适配产品，能够匹配下游客户不同的设计需求。公司在钽电容领域多年的可靠性管控经验，可直接复用到本次拟新建的聚合物钽电容产线，有效降低良率爬坡风险。

2）钽电容需求增长，同时公司已完成部分下游客户导入，具备扩产基础

在 AI、通信等领域快速增长的背景下，钽电容需求呈现明显的增长趋势，国产替代诉求明显。公司片式高分子聚合物钽电容产品已导入国内服务器、存储等领域的头部厂商，完成样品验证并实现批量供货，本次投资建设聚合物钽电容产线是公司抓住市场窗口、客户需求的重要举措，具备市场和客户基础。

3）公司建立了稳定的供应链体系，能够保障生产经营的稳定性

公司与东方钽业、稀美资源等电容级钽粉供应商建立了稳定的长期合作，同时采取开发备选钽粉渠道、提前锁定长协采购量、内部优化钽粉利用率等举措对冲钽价波动风险，有效降低原材料价格波动对公司生产经营的冲击。公司采用多源供应商策略，主要原材料、关键辅材保证至少有 2 家合格供方，降低单一供应商断供风险，保障生产经营的稳定性。

3、项目实施主体及实施地点

本项目实施主体为湘怡电子，实施地点为湖南省湘乡市。

4、项目建设期

本项目建设周期为 36 个月。

5、项目投资概算

本项目预计总投资为 58,136.45 万元，拟使用募集资金投入 53,000.00 万元。本项目的具体投资构成如下：

序号	项目	投资金额（万元）	投资金额占比
1	建设投资	51,968.14	89.39%
1-1	工程费用	50,413.10	86.72%
1-2	工程建设其他费用	41.40	0.07%
1-3	预备费	1,513.64	2.60%
2	铺底流动资金	6,168.31	10.61%
合计		**58,136.45**	**100.00%**

6、项目效益分析

经可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。

7、项目涉及报批事项

（1）项目境内审批情况

截至本预案披露日，本项目所涉及境内投资项目各项备案及审批正在办理中，相关程序的办理预计不存在实质性障碍。

（2）项目境外审批情况

本项目不涉及境外审批事项。

（二）陶瓷薄膜电路与 SLC 产业化建设项目

1、项目概况

陶瓷薄膜电路和 SLC 是 AI 数据中心与光通信领域的核心硬件，其中陶瓷薄膜电路是光模块激光器/探测器封装、AI 加速器与射频前端模块高密度互连的关键基板，SLC 是 800G/1.6T/3.2T 光模块射频前端线路中耦合、滤波、旁路、匹配功能的首选元器件之一。为把握 AI、通信等领域的历史发展机遇，公司决定投资扩建陶瓷薄膜电路和 SLC 生产线，实现两类产品的协同，完成从单品类产品供应商向“基板+器件”整体解决方案供应商的升级，实现品牌影响力和市场竞争力的全面提升。

2、项目的必要性和可行性

（1）必要性

1）满足下游应用领域对高频元件的刚性需求

随着 AI 和通信领域的快速发展，AI 数据中心等应用场景对高速光模块的需求迅速增长，拉动陶瓷薄膜电路和 SLC 的需求成倍增长，供货紧张态势明显。公司投资建设本项目是抢抓历史机遇、承接下游应用领域对高频元件需求爆发的必要布局。

2）响应政策要求，进一步提升市场占有率

目前，高端陶瓷薄膜电路、SLC 产品仍以日本、美国等外资企业为主导，随着下游需求迅速增长，国产替代空间显著。公司投资建设本项目顺应“十五五规划”提出的“发展高端、短缺产品，加快突破关键零部件、元器件和专用材料”及“建立健全产业链供应链安全风险评估和应对机制”的政策方向，是进一步提升市场占有率的重要举措。

3）实现产品矩阵的完善与升级

公司深耕电子元器件领域多年，已与多家国内知名通信行业龙头公司国产化项目组对接，部分送样产品已通过客户可靠性实验室综合认证。但受产能规模限制，无法满足 AI 数据中心与光通信领域新产品类别的开发和规模化生产需求，本项目实施将拓宽产品规格种类、完善产品结构，是公司发展战略落地的必要支撑。

（2）可行性

1）公司已建立了完善的技术工艺体系，具备技术基础

公司已掌握细微晶粒烧结技术与高致密磁控溅射技术，能够通过氢气/氮气流量、烧结温度与时间等参数控制晶粒大小与晶界宽度，通过基片温度、溅射气压、溅射时间与功率控制获得高致密高结合力金属薄层，满足金线焊接要求。公司已积累并掌握陶瓷材料、金属化及图形化工艺，本项目拟生产的产品所需工艺

可在前述基础上延伸，与公司现有技术体系具有高度协同性。公司投资建设本项目具备技术基础和技术可行性。

2）市场空间广阔，具备客户基础

受下游应用领域高速增长的影响，陶瓷薄膜电路、SLC 需求预计将持续增长，市场空间广阔。同时，公司持续将核心技术与产品向光通信产业相关领域拓展，已成为多家国际头部光模块厂商合格供应商，具备扎实的市场和客户基础。

3、项目实施主体及实施地点

本项目实施主体为宏达电子，实施地点为湖南省株洲市。

4、项目建设期

本项目建设周期为 24 个月。

5、项目投资概算

本项目预计总投资为 50,170.55 万元，拟使用募集资金投入 47,000.00 万元。本项目的具体投资构成如下：

序号	项目	投资金额（万元）	投资金额占比
1	建设投资	43,675.05	87.05%
1-1	工程费用	42,338.35	84.39%
1-2	工程建设其他费用	64.61	0.13%
1-3	预备费	1,272.09	2.54%
2	铺底流动资金	6,495.50	12.95%
合计		**50,170.55**	**100.00%**

6、项目效益分析

经可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。

7、项目涉及报批事项

（1）项目境内审批情况

截至本预案披露日，本项目所涉及境内投资项目各项备案及审批正在办理中，相关程序的办理预计不存在实质性障碍。

（2）项目境外审批情况

本项目不涉及境外审批事项。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次发行的募投项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，募集资金运用方案合理、可行。

本次发行的募投项目顺利实施后，不会改变公司现有的主营业务，同时将优化公司产能布局，公司整体实力将进一步提高，业务优势将进一步凸显，提高公司未来整体盈利水平。本次发行符合公司长期发展需求及全体股东的利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位并投入使用后，公司的总资产和净资产规模、筹资活动现金流入均将有所增长，公司的资金实力将进一步得到提升。本次向特定对象发行有利于增强公司的抗风险能力及经营稳健性，为公司和股东带来更好的长期回报。

本次发行的募投项目围绕公司战略和主业，募投项目顺利实施后，公司主营业务规模预计将有效扩大，从而能更好地满足快速增长的市场需求。由于募投项目产生效益需要一定的过程和时间，因此不排除短期内公司每股收益被摊薄的可能性。

四、本次发行的可行性结论

本次发行募集资金使用计划符合相关产业政策和法律法规的要求，符合未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，提升公司整体实力及盈利能力，增强公司后续融资能力和可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，同时本次发行将优化公司的资本结构，降低公司的财务风险，符合公司及全体股东的利益。

株洲宏达电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日